

會議論文徵稿通知- ISPD 2021

ACM 國際實體設計技術研討會

2021 年 3 月

地點：加州矽谷及世界各地虛擬參與

ACM SIGDA / IEEE CAS 聯合贊助

國際實體設計技術研討會提供與會者一個頂尖論壇，以交流意見並促進超大型積體電路系統實體設計的研究。ISPD 2021 將著重於全球 ASIC 和 FPGA 傳統實體設計以及本領域新興技術的最新研究成果。ISPD 2021 會議將結合實體與虛擬會議，並為虛擬與會者提供即時視頻和預錄會議。ISPD 2021 將特別致敬 Louis Scheffer 博士對實體設計界的貢獻。更多詳情請參閱網站 <http://www.ispd.cc>。

會議相關的主題包括但不限於：

佈局規劃和連線規劃	新興技術的實體設計
分割、擺置和繞線	硬體安全相關之實體設計
時脈與電源網絡	與系統和邏輯設計的交互作用
時序和功耗估算與建模	數據管理、多執行緒/分散式演算法
製造可行性和良率的實體設計與優化	實體設計環境中的電路分析
實體合成	實體設計中的機器學習

重要時程

標題和摘要提交截止日期	2020 年 10 月 2 日
完整的稿件提交截止日期	2020 年 10 月 12 日
論文接受通知	2020 年 11 月 13 日
論文完稿	2021 年 1 月 31 日
會期	2021 年 3 月 21 至 24 日

論文提交

所有論文必須透過網站 <https://easychair.org/conferences/?conf=ispd2020> 以電子方式投稿。詳情將在網站 <http://www.ispd.cc> 上公告。作者將被要求提交完整、原創、未發表的論文（ACM 會議格式至多 8 頁）。接受的論文將發表於 ACM 出版之會議論文集。ISPD 設有最佳論文獎表彰優秀的貢獻，並將邀請特選論文的延伸版本投稿至期刊特刊。已發表的論文或已提交其他會議/期刊發表的論文將不予考慮。如果相關論文先前已經發表或同時在他處提交，作者應明確說明這些論文與當前提交的論文之間的差異。所有提交的論文都將進行盲審，因此不得在稿件的任何地方表明作者姓名或所屬機構。違反這些要求將導致論文被自動拒絕。接受論文的作者必須提供簡報檔並同意於大會網頁公開，版權歸作者所有。大會將錄製簡報並提供與線上與會者。

大會組織

大會主席	Jens Lienig (Dresden University of Technology)
指導委員會主席	William Swartz (TimberWolf Systems, Inc. & UT Dallas)
議程主席	Laleh Behjat (University of Calgary), Stephen Yang (Xilinx)
出版主席	David Chinnery (Mentor, a Siemens Business)
公關主席	Iris Hui-Ru Jiang (National Taiwan University)
財務主席	Patrick Madden (Binghamton University)
網站管理員	Wayne Tung-Wei Lin (University of California, Berkeley)

International Symposium
on Physical Design

